

KF 配件密封

去除腐蝕，提高處理製程

精心設計元件

KF 配件常見於 CVD 和蝕刻等半導體晶圓製程系統中，由於操作溫度一般較高，因而對這類應用的密封設計帶來了極大的挑戰。高溫情況下密封件通常會膨脹，並對密封造成較高的壓縮力。如此一來，密封件所承受的應力較大，性能也隨之快速退化。

Greene, Tweed 的 KF 配件密封採用了獨特的雙突圓設計，可改善高溫應用上的壓縮變形回復特性，進而在各種半導體製程環境中提供絕佳的耐受力，並可與不銹鋼和鋁製元件並用，而無須擔心密封性能退化或金屬腐蝕。KF 配件密封具有全部標準尺寸。

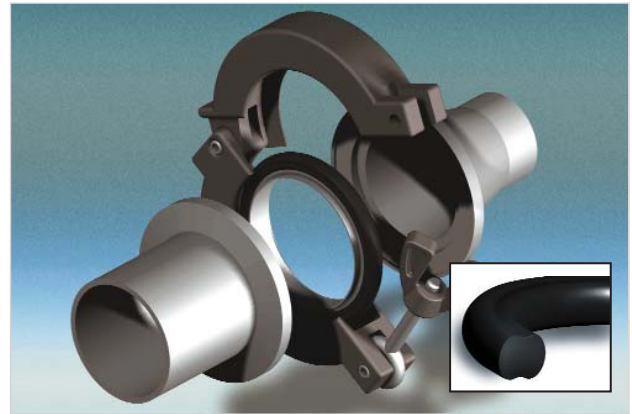
特色與優點

- 在高溫下不會侵蝕不銹鋼
- 雙突圓設計，可提高密封完整性
- 能在 324°C (615°F) 高溫下抵禦機械應力

應用範圍

LPCVD，蝕刻，熔爐及其他製程系統元件：

- 排氣口
- 進氣系統
- 洗滌器



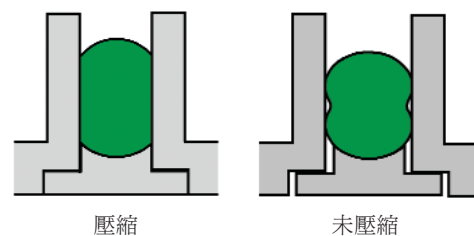
鋁製 ISO-KF 配件測試

	壓縮變形回復特性*	溢漏測試**	
		初始溢漏速度	最終溢漏速度
Chemraz® 653	26%	1 x 10 ⁻⁹ cc/秒	7 x 10 ⁻⁹ cc/秒
競爭對手產品	53%	1 x 10 ⁻⁹ cc/秒	3 x 10 ⁻⁷ cc/秒

*壓縮變形回復特性測試在 300°C (572°F) 下進行，歷時 70 小時。

**溢漏測試在 300°C (572°F) 下進行，歷時 24 小時，然後在室溫下進行。

在壓縮變形回復特性測試中，除了壓縮變形比競爭對手所用材料少一半，Chemraz® 653 全氟化彈性體 KF 配件密封還能在高溫下長時間提供更高的抗漏能力。雖然在初始安裝時，Greene, Tweed 的密封件和競爭對手所用的材料表現都很出色，但在同樣的測試條件下，競爭對手所用的材料卻未能保持真空。



壓縮

未壓縮

本文件中之說明與建議乃是以我們對該產品在一般應用上的經驗與認識為基礎，應不構成該產品的性能保證，亦非為我們對該產品適用標準保證之修訂或變更。

建議您在實際使用之前，先進行相容性測試，以確定是否適合特定的應用。鑒於故障可能導致損傷或損壞，故這點非常重要。另應定期進行檢查與更換。Greene, Tweed 技術人員會協助提供相關建議。

聯絡方式

Greene, Tweed
Semiconductor
Hsin Chu, Taiwan ROC

電話：+886.3.516.9068
傳真：+886.3.516.9069

www.gtsemi.com